

合肥颀中科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演/反路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参加 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
来访单位名称	长江证券、国寿资产、国联民生、东方证券、中信资管等
时间	2026年1月14日-2026年1月15日
上市公司接待人员姓名	总经理：杨宗铭 副总经理、董事会秘书、财务总监：余成强
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 问：公司最近上市的可转换公司债券募投项目的整体规划？</p> <p>答：在显示驱动芯片封测领域，公司计划通过“高脚数微尺寸凸块封装及测试项目”的落地实施，提升显示驱动芯片铜镍金凸块的产能规模，同步扩大CP、COG、COF环节的产能供给。此举将进一步完善公司在显示驱动芯片封测业务的整体布局与产品矩阵，从而巩固在显示驱动芯片封测领域——尤其是铜镍金细分领域的市场领先地位；在非显示类芯片封测领域，公司依托在凸块制造、晶圆减薄等工艺的深厚积累，积极布局“FSM（正面金属化）+BGBM（背面减薄与金属化）+Cu Clip（铜片夹扣键合）”的先进封装组合，建立载板覆晶封装（FC）制程，优化公司产品布局，拓宽功率芯片应用领域，本次募投项目的实施将有利于提升公司非显示类封测业务全制程服务能力，带动现有制程的业务拓展。</p> <p>2. 问：公司目前研发情况如何？目前有多少专利？自有资金能否支撑持续的研发需求？</p> <p>答：公司始终重视研发体系建设、坚持以市场为导向，与客户紧密合作，坚持对技术和产品的研发投入，包括人才的培养引进及资源的优先保障，建立了高素质的核心管理团队和专业化的核心研发团队。截至2025年6月末，公司已取得154项授权专利和1项软件著作权，其中154项授权专利包括：发明专利</p>

	<p>70项（中国57项，国际13项）、实用新型专利83项，外观设计专利1项。公司自有资金能够支撑持续的研发需求。</p> <p>3. 问：公司未来三年有什么样的规划？</p> <p>答：关于公司未来三年的发展规划，我们将持续保持聚焦主业经营，提升经营质量与效率，延伸技术产品线，优化产品结构，以技术创新为驱动，持续提升核心竞争力，力争在未来三年实现经济效益与创新能力的协同增长，为投资者创造长期稳定的价值回报。</p> <p>4. 问：公司铜镍金收入占营收比是多少？</p> <p>答：2025年第三季度，公司铜镍金收入占比约17%。</p> <p>5. 问：公司的价格趋势如何？</p> <p>答：目前综合考量下，公司预计仍以保持价格的稳定为优先。后续，公司将视市场供需情况，再做进一步评估。</p> <p>6. 问：黄金价格的波动会对公司有什么影响？</p> <p>答：黄金主要用于显示驱动芯片上，而公司目前生产上所用到的黄金成本基本可转嫁至下游客户，由其承担价格波动的主要风险，因此黄金价格波动对公司产品毛利影响不大。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动，公司严格按照相关规定沟通交流，不存在未公开重大信息泄露等情形。
附件清单（如有）	无
日期	2026年1月15日